

第 53 回 電子デバイス実装研究委員会



日時：2025 年 7 月 22 日（火）13:00～16:45

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 尾形 繁行（OKI ネクステック株式会社）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『高密度実装基板に向けたナノインプリント工法を用いた高アスペクト比の微細配線技術』

（40 分）……………○坂本 浩捷^{*1}、三宅 弘人^{*1}、八甫谷 明彦^{*1}、見山 克己^{*2}
（^{*1} 株式会社ダイセル、^{*2} 北海道科学大学）

13:50～14:30

『次世代デバイスを支える低抵抗・低熱抵抗 DMB-bump による超音波接合技術』（40 分）

……………○中居 誠也（株式会社アドウェルズ）

14:30～15:10

『複合粒子焼結接合材料を用いた高信頼性パワー半導体実装構造の性能評価』（40 分）

……………○陳 伝彤（大阪大学 産業科学研究所 フレキシブル実装協働研究所）

15:10～15:25 休憩

司会 作山 誠樹（Rapidus 株式会社）

15:25～16:05

『伸縮電子デバイスや半導体パッケージングのための強靱な電子素子実装技術』（40 分）

……………○佐藤 峻^{*1}、岩瀬 英治^{*2}、来見田 淳也^{*1}、岩崎 渉^{*1}
（^{*1} 産業技術総合研究所センシング技術研究部門、^{*2} 早稲田大学理工学術院）

16:05～16:45

『非反応性ナノ粒子添加による低温系はんだ合金の高強度化』（40 分）

……………○新田 隼也^{*1,2}、巽 裕章^{*2}、西川 宏^{*2}
（^{*1} 大阪大学大学院工学研究科、^{*2} 大阪大学接合科学研究所）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会